

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制



芯联集成电路制造股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的
芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司股东全部权益价值
资产评估报告

金证评报字【2024】第 0269 号
（共一册，第一册）



金证（上海）资产评估有限公司

2024 年 8 月 19 日

中国资产评估协会

资产评估业务报告备案回执

报告编码:	3132020024202400372
合同编号:	金证评合约字【2024】第07025号
报告类型:	法定评估业务资产评估报告
报告文号:	金证评报字【2024】第0269号
报告名称:	芯联集成电路制造股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司股东全部权益价值资产评估报告
评估结论:	8,152,000,000.00元
评估报告日:	2024年08月19日
评估机构名称:	金证（上海）资产评估有限公司
签名人员:	杨洁（资产评估师） 会员编号：11100341 林骁（资产评估师） 会员编号：31180075
 (可扫描二维码查询备案业务信息)	

说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。

备案回执生成日期：2024年08月27日

目 录

声 明.....	2
摘 要.....	3
正 文.....	6
一、 委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况.....	6
二、 评估目的.....	11
三、 评估对象和评估范围.....	11
四、 价值类型.....	14
五、 评估基准日.....	14
六、 评估依据.....	15
七、 评估方法.....	18
八、 评估程序实施过程和情况.....	26
九、 评估假设.....	27
十、 评估结论.....	28
十一、 特别事项说明.....	30
十二、 资产评估报告使用限制说明.....	33
十三、 资产评估报告日.....	33
附 件.....	35

声 明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。

本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

四、评估对象涉及的资产和负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。

五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。

七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

芯联集成电路制造股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的

芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司股东全部权益价值

资产评估报告

摘要

特别提示：本摘要内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。

金证（上海）资产评估有限公司接受芯联集成电路制造股份有限公司、绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和市场法，按照必要的评估程序，对芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司股东全部权益在 2024 年 4 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况摘要如下：

委托人：芯联集成电路制造股份有限公司、绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

被评估单位：芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司。

经济行为：根据芯联集成电路制造股份有限公司《芯联集成电路制造股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》，芯联集成电路制造股份有限公司拟购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33% 股权。

评估目的：发行股份及支付现金购买资产。

评估对象：芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司的股东全部权益。

评估范围：芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司的全部资产和负债，包括流动资产、债权投资、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产及负债。

价值类型：市场价值。

评估基准日：2024 年 4 月 30 日。

评估方法：资产基础法和市场法。

评估结论：本评估报告选取市场法评估结果作为评估结论。经市场法评估，被评估单位股东全部权益于评估基准日的市场价值为人民币 815,200.00 万元，大写捌拾壹亿伍仟贰佰万元整。

评估结论使用有效期：为评估基准日起壹年，即有效期至 2025 年 4 月 29 日截止。

特别事项说明：

1、芯联集成电路制造股份有限公司持有被评估单位 27.667%的股权，与广东辰途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）、广州辰途华明创业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州辰途华景创业投资基金合伙企业（有限合伙）、广东辰途十六号创业投资合伙企业（有限合伙）、广州辰途十五号创业投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）签署了《一致行动协议》，可实际支配被评估单位股东会表决权的 51.67%；根据被评估单位的公司章程，董事会决议须经出席董事会会议的过半数董事通过。被评估单位董事会由 3 名董事组成，由芯联集成电路制造股份有限公司提名 2 名；被评估单位设总经理 1 名，由芯联集成电路制造股份有限公司提名，全面负责被评估单位日常经营与管理工作。综上，芯联集成电路制造股份有限公司拥有对被评估单位的控制权，纳入合并报表，即本次并购交易不涉及控制权变更。

2、截止评估基准日，纳入本次评估范围的房屋建筑物均已办理竣工验收，但尚未办理不动产权证，房屋建筑物所属土地不动产权证编号为“浙（2022）绍兴市不动产权第 0021554 号”，证载面积为 124,561.15 平方米，土地性质为出让，土地用途为工业用地，土地使用期限为 2068 年 5 月 9 日止，证载权利人为：绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（委托人芯联集成电路制造股份有限公司的曾用名），本次房屋建筑物面积以企业提供的竣工测绘报告的实测面积为依据，最终建筑面积以房管部门颁发的权属证明为准。

根据委托人芯联集成电路制造股份有限公司和被评估单位提供的相关资料，被评估单位作为委托人二期晶圆制造项目的实施主体，在其设立前的土地出让及厂房批建手续均由母公司芯联集成电路制造股份有限公司实施。2022 年 2 月和 4 月，被评估单位分两次合计支付二期土地款共计 86,610,269.16 元，于其他非流动资产科目核算。后一期和二期土地进行合并再分割，并于 2022 年 6 月 20 日按分割后面积办理土地不动产权证。

2022 年 9 月双方签署《资产转让协议》，约定二期土地转让款为 90,310,000.00 元，与前述已支付款项差异尚未结算。本次评估考虑到土地不动产权证尚未进行变更，且双方协议签署时点距离评估基准日时点间工业用地市场未发生重大变化，故对其他非流动资产-预付不动产款按账面值确认评估值。

3、截至评估基准日，企业存在以下抵押事项：

序号	抵押物	抵押权人	抵押期限
1	根据抵押合同（合同编号：2022 年绍银团抵字第 002 号），芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司将其拥有的 177（个/台/套）集成电路设备进行抵押，协议作价人民币 3,004,800,569.82 元。	招商银行股份有限公司绍兴分行 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行 北京银行股份有限公司绍兴分行 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 中国工商银行股份有限公司绍兴越城支行	2024/4/2-2034/1/1

经现场清查核实，上述抵押物于被评估单位账务系统中登记为 179（个/台/套），截止评估基准日相关抵押资产账面原值 2,832,920,350.19 元，账面净值 2,087,148,346.31 元。

本次评估未考虑上述房地产权属瑕疵、设备抵押事项对评估结论的可能影响，提醒报告使用者注意。

4、根据绍兴滨海新区管委会（甲方）与绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（乙方）（芯联集成电路制造股份有限公司曾用名）签署的《中芯绍兴二期项目落户协议》，甲方对二期项目实施主体即被评估单位提供如下补贴：①设备补贴：用于项目动力系统、净化系统、供应系统和生产线设备及设备相关的安装费、调试费、测试费、系统软件等投资的 12% 给予现金补贴；②土建补贴：土建工程（含水电、消防等）按合资公司支出的 10% 给予现金补贴，竣工验收合格后补贴，补贴依据以第三方审计的未税发票金额为准，审计报告出具之日起 60 日内兑现到账（以项目备案为限）。

评估人员在查阅相关落户协议、专项审计报告、历史年度取得补贴的会计凭证核实其真实性的基础上对负责政策落实的绍兴集成电路产业园管委会相关负责人员进行了访谈，对协议的真实性、补贴的可得性等进行了论证。

经核实，被评估单位于 2024 年 6 月 30 日收讫 2022 年度设备补贴余款 23,076,999.27 元；截止评估报告出具日，2023 年度设备补贴专项审计工作尚未完成，党工委会议对相关补贴的决策暂未明确，故基于谨慎性原则仅将已收讫的政府补助纳入评估范围，根据实际收讫时点对相关补贴款考虑其时间价值，以其现值作为评估值。

其他特殊事项详见本报告正文的“特别事项说明”部分。

芯联集成电路制造股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的

芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司股东全部权益价值

资产评估报告

正文

芯联集成电路制造股份有限公司、绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）：

金证（上海）资产评估有限公司接受贵方的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和市场法，按照必要的评估程序，对芯联集成电路制造股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产之经济行为所涉及的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司股东全部权益在 2024 年 4 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况

（一）委托人

委托人 1：

企业名称：芯联集成电路制造股份有限公司

证券简称：芯联集成 证券代码：688469

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

住 所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号

法定代表人：赵奇

注册资本：702,180.00 万元人民币

经营范围：半导体（硅及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试、测试封装；先进晶圆级封装；电子元器件及光学元器件研发及制造；光刻掩膜版开发制造；模具制造与加工；与集成电路、电子/光学元器件有关的开发、设计服务、技术服务；销售自产产品，并提供相关技术咨询和技术服务；从事货物及技术的进出口业务；自有设备、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

委托人 2：

企业名称：绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

住 所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道银桥路 326 号 1 幢 1 楼 105 室

执行事务合伙人：宁波北芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

经营范围：一般项目：股权投资基金（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）被评估单位

1. 基本情况

企业名称：芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

住 所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 508 号

法定代表人：赵奇

注册资本：300,000.00 万元人民币

经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；住房租赁（限自有房屋）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 历史沿革

（1）公司设立

芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司，原名为“中芯越州集成电路制造（绍兴）有限公司”，于 2021 年 12 月由芯联集成电路制造股份有限公司、绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广东辰途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）、广州辰途华明创业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州辰途华景创业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海横琴强科二号股权投资合伙企业（有限合伙）、张家港毅博企业管理中心（有限合伙）、尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）、井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡芯朋微电子股份有限公司、华民科文（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、广东导远科技有限公司、广东辰途十六号创业投资合伙企业（有限合伙）、广州辰途十五号创业投资基金合伙企业（有限合伙）、锐石创芯（深圳）科技股份有限公司共同出资组建，股东共同出资人民币 600,000.00 万元，其中 300,000.00 万元计入注册资本，300,000.00 万元计入资本公积，成立时各股东出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	芯联集成电路制造股份有限公司	83,000.00	27.667%
2	绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	75,000.00	25.00%
3	深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,000.00	10.00%
4	广东辰途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）	23,000.00	7.667%

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	认缴出资比例
5	广州辰途华明创业投资基金合伙企业(有限合伙)	22,500.00	7.50%
6	广州辰途华景创业投资基金合伙企业(有限合伙)	12,500.00	4.167%
7	珠海横琴强科二号股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	3.333%
8	张家港毅博企业管理中心(有限合伙)	10,000.00	3.333%
9	尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)	10,000.00	3.333%
10	井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000.00	1.667%
11	无锡芯朋微电子股份有限公司	5,000.00	1.667%
12	华民科文(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙)	5,000.00	1.667%
13	广东导远科技有限公司	4,000.00	1.333%
14	广东辰途十六号创业投资合伙企业(有限合伙)	2,650.00	0.883%
15	广州辰途十五号创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,350.00	0.45%
16	锐石创芯(深圳)科技股份有限公司	1,000.00	0.333%
	合计	300,000.00	100.00%

(2) 公司更名

2023年10月,根据《中芯越州集成电路制造(绍兴)有限公司公司2023年第二次临时股东大会会议决议》,公司名称变更为芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司。

截至评估基准日2024年4月30日,芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司的股东情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	芯联集成电路制造股份有限公司	83,000.00	27.667%
2	绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	75,000.00	25.00%
3	深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	30,000.00	10.00%
4	广东辰途华辉创业投资合伙企业(有限合伙)	23,000.00	7.667%
5	厦门辰途华明创业投资基金合伙企业(有限合伙)	22,500.00	7.50%
6	厦门辰途华景创业投资基金合伙企业(有限合伙)	12,500.00	4.167%
7	珠海横琴强科二号股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	3.333%
8	张家港毅博企业管理中心(有限合伙)	10,000.00	3.333%
9	尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)	10,000.00	3.333%
10	井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000.00	1.667%
11	无锡芯朋微电子股份有限公司	5,000.00	1.667%
12	华民科文(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙)	5,000.00	1.667%
13	广东导远科技有限公司	4,000.00	1.333%
14	广东辰途十六号创业投资合伙企业(有限合伙)	2,650.00	0.883%
15	广州辰途十五号创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,350.00	0.45%
16	锐石创芯(深圳)科技股份有限公司	1,000.00	0.333%
	合计	300,000.00	100.00%

截止评估报告日,广东辰途华辉创业投资合伙企业(有限合伙)名称变更为厦门辰途华辉创业投资合伙企业(有限合伙)、广州辰途华明创业投资基金合伙企业(有限合伙)名称变更为厦门辰途华明创业投资基金合伙企业(有限合伙)。

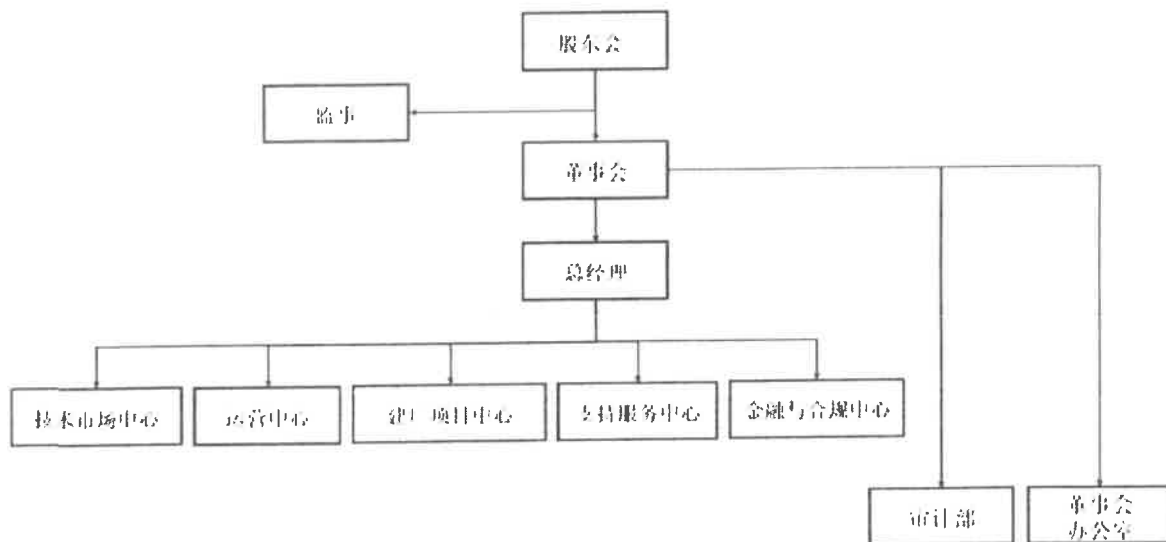
3. 企业经营概况

芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司系芯联集成电路制造股份有限公司二期项目的实施主体，目前拥有 7 万片/月的 8 英寸硅基产能和 5 千片/月的 6 英寸 SiC MOSFET 产能。SiC MOSFET 主要应用于新能源汽车，产品核心技术参数比肩国际龙头水平，是国内率先突破主驱用 SiC MOSFET 产品，2023 年国内出货量第一，已成为亚洲 SiC MOSFET 出货量居前的制造基地，并帮助公司获得理想、蔚来等多家头部新能源车企的长期战略合作协议。

企业 8 英寸 SiC MOSFET 产品目前已经通过工程批，是目前国内首家实现工程批企业，该技术达到国际同行业水平。企业目前为国内少数提供车规级芯片的晶圆代工企业之一，车规级 BCD 工艺平台不断向高压、高功率、高密度方向发展，能够满足客户在汽车、高端工控等应用领域在智能化、AI 时代对于完整高压、大电流与高密度技术的模拟和电源方案的需求。目前国内市场主要集中在面向消费类和工业级应用的低压 BCD 工艺技术，中高压领域较少实现突破，上述平台目前国内较为稀缺。

4. 经营管理结构

企业的组织结构图如下：



企业拥有的控股企业概况如下：

金额单位：万元

企业名称	成立时间	注册资本	持股比例	
			直接	间接
芯联先进集成电路制造（绍兴）有限公司	2023 年 9 月	1,000.00	100%	

截止评估基准日，芯联先进集成电路制造（绍兴）有限公司尚未开展实际生产经营活动。

5. 近年资产、财务、经营状况

企业近两年一期（合并报表）的财务状况和经营成果概况如下：

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2024 年 4 月 30 日
资产总计	1,077,453.94	1,042,100.73	1,054,111.37
负债合计	571,109.72	646,977.63	703,897.28
所有者权益合计	506,344.22	395,123.10	350,214.09
归属于母公司所有者权益合计	506,344.22	395,123.10	350,214.09

项目	2022 年	2023 年	2024 年 1-4 月
营业收入	13,657.86	156,030.99	61,847.66
利润总额	-70,038.54	-111,572.70	-44,997.83
净利润	-70,038.54	-111,572.70	-44,997.83
归属于母公司所有者的净利润	-70,038.54	-111,572.70	-44,997.83

企业近两年一期（母公司报表）的财务状况和经营成果概况如下：

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2024 年 4 月 30 日
资产总计	1,077,453.94	1,042,100.73	1,054,111.37
负债合计	571,109.72	646,977.63	703,897.28
所有者权益合计	506,344.22	395,123.10	350,214.09

项目	2022 年	2023 年	2024 年 1-4 月
营业收入	13,657.86	156,030.99	61,847.66
利润总额	-70,038.54	-111,572.70	-44,997.83
净利润	-70,038.54	-111,572.70	-44,997.83

被评估单位近两年一期的财务报表均已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。

（三）资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人

资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人为委托人的各方股东及相关方和标的公司的各股东及关联方。

除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

二、评估目的

根据芯联集成电路制造股份有限公司《芯联集成电路制造股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》，芯联集成电路制造股份有限公司拟购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33% 股权，为此需要对芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司的股东全部权益价值进行评估，为上述经济行为提供价值参考依据。

三、评估对象和评估范围

（一）评估对象和评估范围概况

本次评估对象为芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司的股东全部权益，本次拟实施的经济行为为部分股权收购，经与委托人沟通一致确定本次评估对象为被评估单位股东全部权益价值。

本次评估范围为芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司的全部资产和负债，包括流动资产、债权投资、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产及负债。母公司报表总资产账面价值 10,541,113,687.88 元，总负债账面价值 7,038,972,792.66 元，所有者权益账面价值 3,502,140,895.22 元；合并报表总资产账面价值 10,541,113,687.88 元，总负债账面价值 7,038,972,792.66 元，所有者权益账面价值 3,502,140,895.22 元，归属于母公司所有者权益账面价值 3,502,140,895.22 元。

委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致，评估范围内的资产、负债账面价值已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告为无保留意见。

（二）评估范围内主要资产概况

本次评估范围中的主要资产包括流动资产、固定资产、在建工程 and 无形资产。

流动资产主要包括货币资金、应收款项、存货和其他流动资产等。

固定资产-房屋建筑物包括生产厂房、动力厂房、化学品库、门卫室、控制室等，共 19 项，账面原值 937,927,209.74 元，账面价值 890,646,072.48 元，建筑面积合计 229,087.55 m²，均未办理房产证。

固定资产-构筑物包括停车棚、室外道路、围墙等，共 11 项，账面原值 43,906,432.54 元，账面价值 41,899,733.09 元。

固定资产-设备包括机器设备、电子及其他设备，共计 6,950 台（套/项/组/辆），账面原值 8,275,726,641.26 元，账面价值 6,529,681,211.59 元，均处于正常使用状态。

在建工程为设备安装工程，账面价值 152,428,080.97 元，主要为 SiC MOSFET 生产线尾气处理项目、厂务气体系统扩充工程等设备安装工程。

无形资产-其他无形资产共计 128 项, 包括软件 15 项、软件使用费 17 项、特许使用权 5 项, 专有技术 10 项、专利权 23 项及专利申请权 58 项, 其中专有技术 10 项、专利权 23 项及专利申请权 58 项在账面未反映。企业拥有的专有技术、专利权及专利申请权清单如下:

专有技术

序号	项目名称
1	用于射频前端的射频器件技术研发
2	用于三维感知的 MEMS 激光技术研发
3	SiC MOSFET 技术研发
4	用于工业和车载的功率器件集成技术研发
5	用于消费类 MEMS 模拟技术研发
6	第二代车载 SGT (屏蔽栅沟槽型 MOSFET) 技术研发
7	高功率超结 MOSFET 技术研发
8	用于射频前端的第二代射频器件技术研发
9	第三代屏蔽栅沟槽型 MOSFET 技术研发
10	逆导 IGBT 技术研发

专利权清单

序号	专利号	专利名称	申请日期	授权公告日	专利类别	专利状态
1	ZL201911018833.X	温度补偿型表面声波滤波器件及其制造方法	2019/10/24	2022/8/26	发明专利	授权
2	ZL202010244999.X	压电器件及其形成方法	2020/3/31	2022/9/9	发明专利	授权
3	ZL202211223946.5	HBT 器件和保护电路的集成结构及其制备方法	2022/10/9	2023/2/3	发明专利	授权
4	ZL202110816506.X	氮化镓基器件及其制造方法	2021/7/20	2021/11/19	发明专利	授权
5	ZL202110186694.2	碳化硅衬底上的缓冲层及其形成方法	2021/2/18	2021/4/23	发明专利	授权
6	ZL202110731269.7	SiC 基欧姆接触结构及其制造方法	2021/6/30	2022/3/18	发明专利	授权
7	ZL202210244334.8	激光退火均匀性的验证方法	2022/3/14	2022/8/12	发明专利	授权
8	ZL202210526000.X	碳化硅器件及其制备方法	2022/5/16	2023/6/9	发明专利	授权
9	ZL202210618553.8	沟槽型 MOS 器件及其制造方法	2022/6/2	2022/8/26	发明专利	授权
10	ZL202211305002.2	MOSFET 器件及其制造方法	2022/10/24	2023/6/30	发明专利	授权
11	ZL202310023965.1	沟槽栅晶体管及其制备方法	2023/1/9	2023/5/2	发明专利	授权
12	ZL202211400274.0	碳化硅平面 MOSFET 器件及其制造方法	2022/11/9	2023/9/22	发明专利	授权
13	ZL202211425863.4	MOSFET 器件及其制造方法	2022/11/14	2023/10/10	发明专利	授权
14	ZL202211045193.3	半导体器件的制备方法	2022/8/30	2024/5/14	发明专利	授权
15	ZL202210603304.1	半导体器件及其制作方法	2022/5/31	2022/9/9	发明专利	授权
16	ZL202310185885.6	常闭型晶体管及其制备方法	2023/3/1	2023/8/11	发明专利	授权
17	ZL202410370800.6	键合结构、晶圆的键合方法及晶圆堆叠结构	2024/3/29	2024/6/28	发明专利	授权
18	ZL202410490641.3	一种 MEMS 器件及其制备方法和电子装置	2024/4/23	2024/7/9	发明专利	授权
19	ZL202311681869.2	WAT 测试结构	2023/12/8	2024/5/24	发明专利	授权
20	ZL202410294504.2	WAT 测试结构	2024/3/15	2024/5/28	发明专利	授权
21	ZL202410310155.9	超结结构的制备方法及超结器件的制备方法	2024/3/19	2024/6/7	发明专利	授权
22	ZL202220413901.3	一种机械臂及电镀设备	2022/2/28	2022/10/28	实用新型	授权
23	ZL202223365818.2	一种测量夹具及测量系统	2022/12/15	2023/5/16	实用新型	授权

上述专利权的权利人均均为芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司, 无共有人。

专利申请权清单

序号	申请号	专利名称	申请日期	专利类别
1	202210775331.7	体声波滤波器及其制备方法	2022/7/1	发明专利
2	202211172695.2	半导体结构的平坦化方法及半导体结构的制备方法	2022/9/26	发明专利
3	202211247913.4	异质结双极晶体管及其制备方法	2022/10/12	发明专利
4	202211298112.0	功率放大器及其形成方法	2022/10/21	发明专利
5	202211585981.1	外延结构、半导体器件及制备方法	2022/12/9	发明专利
6	202211287378.5	垂直腔面发射激光器及其制作方法	2022/10/20	发明专利
7	202211393727.1	异质结双极晶体管及其制造方法	2022/11/8	发明专利
8	202211419228.5	氮化镓基高电子迁移率晶体管及其制备方法	2022/11/14	发明专利
9	202211627136.6	硅基砷化镓外延结构、激光器及制备方法	2022/12/16	发明专利
10	202211667878.1	一种异质结双极型晶体管及其制作方法	2022/12/23	发明专利
11	202211690864.1	垂直腔面发射激光器的制备方法及垂直腔面发射激光器	2022/12/27	发明专利
12	202410413644.7	垂直腔面发射激光器及其制造方法	2024/4/8	发明专利
13	202410421182.3	半导体激光器及其制备方法	2024/4/9	发明专利
14	202210883259.X	沟槽栅器件的制备方法及沟槽栅器件	2022/7/26	发明专利
15	202211043513.1	碳化硅器件及其制备方法	2022/8/29	发明专利
16	202211524494.4	碳化硅 MOS 器件及其制造方法	2022/11/30	发明专利
17	202211698059.3	欧姆接触结构及其制作方法、碳化硅器件及其制作方法	2022/12/28	发明专利
18	202310160393.1	避免解键合印记的方法及功率器件的制备方法	2023/2/16	发明专利
19	202310180651.2	一种多通道沟槽型 MOS 器件及其制作方法	2023/2/17	发明专利
20	202310240166.X	一种半导体器件及其制备方法	2023/3/7	发明专利
21	202311676668.3	半导体器件的制造方法	2023/12/7	发明专利
22	202311676783.0	金属半导体接触结构及半导体器件的制造方法	2023/12/7	发明专利
23	202311734540.8	一种 SiC MOSFET 器件的制造方法	2023/12/18	发明专利
24	202410107308.X	超结平面 MOSFET 及其制备方法、超结沟槽 MOSFET 及其制备方法	2024/1/25	发明专利
25	202410239851.5	半导体器件及其制备方法	2024/3/4	发明专利
26	202410267891.0	一种半导体器件及其制造方法	2024/3/8	发明专利
27	202410298304.4	一种碳化硅平面栅极 MOSFET 及其制备方法	2024/3/15	发明专利
28	202410318112.5	晶片分离装置及分离方法	2024/3/20	发明专利
29	202211578903.9	功率放大器	2022/12/5	发明专利
30	202211731798.8	半导体测试电路	2022/12/30	发明专利
31	202310347108.7	结型场效应晶体管制备方法及结型场效应晶体管	2023/3/29	发明专利
32	202410354060.7	半导体器件及其制备方法	2024/3/27	发明专利
33	202211143099.1	沟槽型 MOS 器件的制造方法	2022/9/20	发明专利
34	202211719723.8	芯片失效分析方法	2022/12/30	发明专利
35	202410255987.5	一种半导体器件的制备方法及半导体器件	2024/3/6	发明专利
36	202210813878.1	高电子迁移率晶体管及其制备方法、半导体器件	2022/7/11	发明专利
37	202410109742.1	一种半导体器件的制造方法	2024/1/25	发明专利
38	202410277291.2	一种半导体器件及其制造方法	2024/3/12	发明专利
39	202410410224.3	超结半导体器件及其制造方法	2024/4/7	发明专利
40	202211294893.6	功率放大器及其形成方法	2022/10/21	发明专利
41	202410117321.3	一种半导体器件及其制备方法	2024/1/26	发明专利

序号	申请号	专利名称	申请日期	专利类别
42	202410195566.8	滤波器及其制备方法	2024/2/22	发明专利
43	202410483179.4	BAW 滤波器及其制作方法	2024/4/22	发明专利
44	202410267850.1	一种半导体器件及其制备方法	2024/3/8	发明专利
45	202410322608.X	一种半导体器件及其制备方法和电子装置	2024/3/20	发明专利
46	202311811772.9	半导体器件的制备方法及半导体器件	2023/12/26	发明专利
47	202311816195.2	快恢复二极管及其制备方法和 IGBT 模块	2023/12/27	发明专利
48	202410286884.5	一种半导体器件及其制备方法	2024/3/13	发明专利
49	202410287634.3	一种半导体器件及其制备方法	2024/3/13	发明专利
50	202420572677.1	晶圆整平装置、晶圆清洗设备	2024/3/22	实用新型
51	202323654674.7	半导体测试结构和半导体器件	2023/12/29	实用新型
52	EP23741247.3	MOSFET 器件及其制造方法	2023/7/25	发明专利
53	US18/264,045	MOSFET 器件及其制造方法	2023/8/2	发明专利
54	JP2023-546028	MOSFET 器件及其制造方法	2023/7/27	发明专利
55	WO2023CN82486	MOSFET DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR	2023/3/20	发明专利
56	EP23801660.4	MOSFET 器件及其制造方法	2023/11/16	发明专利
57	JP2023-571303	MOSFET 器件及其制造方法	2023/11/16	发明专利
58	US18/562,219	MOSFET 器件及其制造方法	2023/11/17	发明专利

上述专利申请权的权利人均均为芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司，无共有人。

（三）企业申报的表外资产的类型、数量

企业申报的表外资产为专有技术 10 项、专利权 23 项及专利申请权 58 项，其中专利权 23 项及专利申请权 58 项已取得相应的权利证书或专利申请受理通知书。

（四）引用其他机构出具的报告结论所涉及的资产类型、数量和账面金额（或评估值）
本次评估未引用其他机构出具的报告结论。

四、价值类型

经与委托人沟通，考虑评估目的、市场条件、评估对象自身条件等因素，本次评估选取的价值类型为市场价值。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

五、评估基准日

本项目评估基准日是 2024 年 4 月 30 日。

评估基准日是由委托人在考虑经济行为的实现、会计期末、利率和汇率变化等因素的基础上确定的。

六、评估依据

(一) 经济行为依据

1. 芯联集成电路制造股份有限公司《芯联集成电路制造股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

(二) 法律法规依据

1. 《中华人民共和国资产评估法》(2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过);
2. 《中华人民共和国公司法》(1993年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过, 2023年12月29日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订);
3. 《中华人民共和国企业国有资产法》(2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过);
4. 《中华人民共和国证券法》(1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过, 2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订);
5. 《中华人民共和国城市房地产管理法》(1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过, 2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修正);
6. 《中华人民共和国专利法》(1984年3月12日第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过, 2020年10月17日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议修正);
7. 《中华人民共和国企业所得税法》(2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过, 2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修正);
8. 《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第214号);
9. 《国有资产评估管理办法》(国务院令第91号公布, 国务院令第732号修改);
10. 《国有资产评估管理办法施行细则》(原国家国有资产管理局国资办发[1992]36号);
11. 《企业国有资产评估管理暂行办法》(国资委令第12号);
12. 《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委、财政部令第32号);
13. 《上市公司国有股权监督管理办法》(国务院国资委、财政部、证监会令第36号);
14. 《国有资产评估管理若干问题的规定》(财政部令第14号);
15. 《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》(国资委产权[2006]274号);
16. 《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第378号公布, 国务院令第709号修正);

17. 《国有企业参股管理暂行办法》(国资发改革规[2023]41号);
18. 《关于企业国有资产评估项目备案工作指引》(国资产权[2013]64号);
19. 《关于企业国有资产评估报告审核工作有关事项的通知》(国资产权[2009]941号);
20. 《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》(国资发产权规[2022]39号);
21. 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令 第 512 号公布, 国务院令 第 714 号修订);
22. 《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令 第 134 号公布, 国务院令 第 691 号修订);
23. 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部、国家税务总局令 第 50 号公布, 财政部、国家税务总局令 第 65 号修订);
24. 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号);
25. 《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号);
26. 其他有关法律法规。

(三) 评估准则依据

1. 《资产评估基本准则》(财资[2017]43号);
2. 《资产评估职业道德准则》(中评协[2017]30号);
3. 《资产评估执业准则——资产评估程序》(中评协[2018]36号);
4. 《资产评估执业准则——资产评估报告》(中评协[2018]35号);
5. 《资产评估执业准则——资产评估委托合同》(中评协[2017]33号);
6. 《资产评估执业准则——资产评估档案》(中评协[2018]37号);
7. 《资产评估执业准则——利用专家工作及报告》(中评协[2017]35号);
8. 《资产评估执业准则——企业价值》(中评协[2018]38号);
9. 《资产评估执业准则——无形资产》(中评协[2017]37号);
10. 《资产评估执业准则——不动产》(中评协[2017]38号);
11. 《资产评估执业准则——机器设备》(中评协[2017]39号);
12. 《资产评估执业准则——资产评估方法》(中评协[2019]35号);
13. 《资产评估执业准则——知识产权》(中评协[2023]14号);
14. 《企业国有资产评估报告指南》(中评协[2017]42号);
15. 《资产评估机构业务质量控制指南》(中评协[2017]46号);
16. 《资产评估价值类型指导意见》(中评协[2017]47号);
17. 《资产评估对象法律权属指导意见》(中评协[2017]48号);
18. 《专利资产评估指导意见》(中评协[2017]49号);

19. 《资产评估专家指引第 6 号—上市公司重大资产重组评估报告披露》(中评协[2015]67 号);
20. 《资产评估专家指引第 8 号——资产评估中的核查验证》(中评协[2019]39 号);
21. 《资产评估专家指引第 14 号——科创企业资产评估》(中评协[2021]32 号);
22. 《资产评估准则术语 2020》(中评协[2020]31 号);
23. 其它相关行业规范。

(四) 权属依据

1. 专利证书、专利申请受理通知书;
2. 重要资产购置合同或凭证;
3. 其他权属证明文件。

(五) 取价依据

1. 机械工业出版社出版的《资产评估常用方法与参数手册》;
2. 机械工业出版社出版的《机电产品价格信息查询系统》、《机电产品报价手册》、《机电设备评估价格信息》、《国外机电产品报价手册》;
3. 《房屋完损等级评定标准》(城住字[1984]第 678 号);
4. 浙江省标准造价信息;
5. 绍兴市配套规费信息;
6. 企业提供的项目可行性研究报告、项目投资概算、设计概算等资料;
7. 企业提供的相关工程预决算资料;
8. 企业提供的部分合同、协议等;
9. 国家宏观经济、行业、区域市场及企业统计分析资料;
10. 同行业可比上市公司公开发布的相关资料;
11. 基准日近期国债收益率、贷款利率;
12. 其他相关取价依据。

(六) 其他参考依据

1. 企业提供的资产清单和评估申报表;
2. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告;
3. 企业提供的原始财务报表、账册、会计凭证;
4. 企业提供的经营信息和资料;
5. 评估人员现场调查记录及收集的其他相关估价信息资料;
6. 金证(上海)资产评估有限公司技术资料库;
7. 评估基准日有效的企业会计准则及应用指南;

8. 其它有关参考依据。

七、评估方法

(一) 评估方法选择

企业价值评估的基本方法主要有收益法、市场法和资产基础法。

企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

《资产评估执业准则——企业价值》规定，执行企业价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析收益法、市场法、资产基础法三种基本方法的适用性，选择评估方法。

根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，以及三种评估基本方法的适用条件，本次评估选用的评估方法为资产基础法和市场法。评估方法选择理由如下：

不适宜采用收益法的理由：被评估单位系晶圆代工企业，主要从事功率半导体领域的晶圆代工业务，晶圆代工行业普遍存在前期投资大、产能利用率爬坡周期长、受国际关系和宏观环境影响重大、行业周期性不确定性较强、未来盈利情况难以可靠预测的情况。被评估单位成立于 2021 年末，已经建成月产 7 万片 8 英寸硅基产线和月产 5 千片 6 英寸 SiC MOSFET 产线，历经生产调试、客户验证、产品导入等阶段，生产和销售规模正在交替扩大，但仍然尚未达到稳定期，目前难以对企业未来的盈利情况和所承担的风险进行可靠预测，故不适用收益法评估。

适宜采用资产基础法的理由：资产基础法的基本思路是按现行条件重建或重置委估资产；潜在的投资者在决定投资某项资产时，所愿意支付的价格不会超过该项资产的现行购建成本。被评估单位满足资产基础法评估所需的条件，即被评估单位符合持续经营的假设，具备可利用的历史经营资料，评估基准日资产负债表中各项表内资产、负债及重要的表外资产可被识别并可采用适当的方法单独进行评估，故适用资产基础法。

适宜采用市场法的理由：与被评估单位处于同一行业，产品类型、业务结构、主要经营模式相类似的上市公司数量较多，可比公司股价及经营和财务数据相关信息公开，具备资料的收集条件，故适用市场法评估。

综上，本次采用资产基础法和市场法进行评估。

(二) 市场法简介

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

由于可收集到至少三个与评估对象同行业的可比上市公司，且可比上市公司相关数据容易收集，本次评估采用上市公司比较法。

上市公司比较法评估的基本步骤如下：

1. 选择可比企业

从我国 A 股上市公司中选择与被评估单位属于同一行业，或者受相同经济因素的影响的上市公司。通过比较被评估单位与上述上市公司在业务结构、主要经营模式、经营规模、资产配置和使用情况、所处经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等因素后，进一步筛选得到与被评估单位进行比较分析的可比企业。

首先，根据被评估单位所在的行业、主要经营模式及产品类型进行初步筛选，参照标准如下：

①与被评估单位同属于半导体制造或晶圆代工行业，主要经营模式为大规模投资、高资本支出及技术工艺持续投入的 IDM 或 Foundry 模式且产品应用领域相似。

②评估基准日近期股票正常交易，未处于停牌等非正常交易状态。

③鉴于 ST 股票较可能因市场中的投机、炒作等因素使得股票价格较大程度偏离其实际价值，故将 ST 股票剔除出可比公司范围。

初步筛选后，符合上述参照标准的公司概况如下表所示：

证券代码	证券简称	主营产品名称
600460.SH	士兰微	集成电路、分立器件产品、发光二极管产品
600745.SH	闻泰科技	智能终端、半导体、新型电子元器件、光学模组
688172.SH	燕东微	产品与方案、制造与服务
300373.SZ	扬杰科技	半导体器件、半导体芯片、半导体硅片
300623.SZ	捷捷微电	晶闸管系列、半导体放电管 (TSS)、瞬态抑制二极管 (TVS)、静电防护元、器件 (ESD)、集成防护器件、Y 电容、压敏电阻、二极管系列、MOSFET 系列、IGBT 系列、厚膜组件、碳化硅器件、功率型开关晶体管、达林顿晶体管
688347.SH	华虹公司	功率器件、嵌入式非易失性存储器、模拟与电源管理、逻辑与射频、IP 设计服务、测试服务、晶圆后道加工服务
688396.SH	华润微	功率半导体、智能传感器、智能控制、其他 IC 产品
688469.SH	芯联集成	晶圆-6 英寸、晶圆-8 英寸、晶圆-12 英寸

在初步筛选的基础上，我们进一步根据公司的上市时间、业务结构、关键经营数据等进行最终筛选，相关标准如下：

①截至评估基准日至少已上市两年，以避免市场信息不够充分及 IPO 效应、市场预期等因素造成的股价波动影响。

②近两年营业收入结构中功率半导体或晶圆代工相关业务收入的占比不低于 50%。

证券代码	证券简称	上市日期	主营业务构成
600460.SH	士兰微	2003-3-11	分立器件产品：51.74%；集成电路：33.50%；发光二极管产品：7.94%；其他：4.01%；其他业务：2.81%
600745.SH	闻泰科技	1996-8-28	智能终端：72.26%；半导体产品：23.98%；其他业务：3.76%
688172.SH	燕东微	2022-12-16	集成电路：96.70%；其他业务：3.30%
300373.SZ	扬杰科技	2014-1-23	半导体器件：85.48%；半导体芯片：9.02%；半导体硅片：3.20%；其他业务收入：2.29%
300623.SZ	捷捷微电	2017-3-14	功率半导体器件：69.32%；功率半导体芯片：29.00%；其他业务收入：0.87%；功率器件封测：0.80%
688347.SH	华虹公司	2023-8-7	集成电路晶圆代工：94.63%；其他：4.76%；租赁收入：0.61%
688396.SH	华润微	2020-2-27	半导体开放式晶圆制造、封装测试：51.31%；产品与方案：47.16%；其他业务：1.52%
688469.SH	芯联集成	2023-5-10	集成电路行业：92.23%；其他业务：7.77%

最终筛选确定的可比上市公司概况如下表所示：

证券代码	证券简称	上市日期	主营业务
688396.SH	华润微	2020-2-27	芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营
600460.SH	士兰微	2003-3-11	电子元器件的研发、生产和销售
300373.SZ	扬杰科技	2014-1-23	分立器件芯片、功率二极管、整流桥等半导体分立器件产品的研发、制造与销售
300623.SZ	捷捷微电	2017-3-14	从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售

2.分析调整财务报表

将被评估单位与可比企业的业务情况和财务情况进行比较和分析，并做必要的调整，以使可比企业与被评估单位的各项数据口径更加一致、可比。

3.选择、计算、调整价值比率

根据被评估单位所属行业特征、所处经营阶段等因素，在盈利比率、资产比率、收入比率和其他特定比率中选择适用的价值比率，并计算各可比上市公司的价值比率。接下来，分析可比企业与被评估单位的主要差异因素，建立指标修正体系，将可比企业与被评估单位相关财务数据和经营指标进行比较，并对差异因素进行量化调整，将可比交易案例中的价值比率修正至适用于被评估单位的水平。

价值比率的选择：

(1) 资产价值比率

EVI/总投资：被评估单位系晶圆代工企业，主要从事功率半导体领域的晶圆代工业务，具有高投入、长周期、高技术门槛、规模效应凸显等特征，其核心价值主要体现于质量控制、规模生产、定制化服务、研发支持等多个方面，而晶圆代工的总投资额即核心生产设备、配套生产用房、技术等投入能够从量化角度体现晶圆代工企业的产业竞争力，对确保企业技术领先、满足市场需求有着深远的影响。同时，本次被评估单位属于并购方的并表公司，目前处于产能利用率爬坡阶段的末期，但尚未达到生产销售的稳定期，总投资金额与企业价值之间的关联度较之其他指标更高，故本次评估选取 **EVI/总投资** 这一价值比率进行市场法评估。

其中， $\text{总投资} = \text{固定资产原值} + \text{无形资产原值（不含特许使用权）} + \text{在建工程账面价值} + \text{开发支出账面价值} + \text{其他非流动资产} - \text{预付不动产款、设备款账面价值}$

考虑到被评估单位目前处于产能利用率爬坡阶段，尚未达到盈亏平衡点，目前的净资产水平处于企业生命周期中的相对低位，而可比上市公司均已实现爬坡过坎进入成长期或成熟期，虽然净资产及 **TBVIC** 受行业周期波动的影响较小，但其于企业生命周期的不同阶段呈现较为显著的差异，故不宜采用 **P/B**、**EV/TBVIC** 作为价值比率进行评估。

（2）盈利价值比率

考虑到被评估单位目前处于产能利用率爬坡阶段的末期，暂处亏损状态，与其他可比公司所处的生命周期阶段不同，故不宜采用静态盈利价值比率如 **P/E**、**EV/EBITDA**、**EV/EBIT** 等进行评估。

被评估单位系晶圆代工企业，主要从事功率半导体领域的晶圆代工业务，晶圆代工行业普遍存在前期投资大、产能利用率爬坡周期长、受国际关系和宏观环境影响重大、行业周期性及不确定性较强、未来盈利情况难以可靠预测的情况。被评估单位成立于 2021 年末，已经建成月产 7 万片 8 英寸硅基产线和月产 5 千片 6 英寸 **SiC MOSFET** 产线，历经生产调试、客户验证、产品导入等阶段，生产和销售规模正在交替扩大，但仍然尚未达到稳定期，目前难以对企业未来的盈利情况和所承担的风险进行可靠预测，无法取得动态盈利价值比率评估必要的预测盈利指标，故不宜采用动态盈利价值比率进行评估。

（3）收入价值比率

考虑到被评估单位目前处于产能利用率爬坡阶段的末期，暂处亏损状态，与其他可比公司所处的生命周期阶段不同，故不宜采用静态收入价值比率如 **EV/S** 进行评估。

被评估单位系晶圆代工企业，主要从事功率半导体领域的晶圆代工业务，晶圆代工行业普遍存在前期投资大、产能利用率爬坡周期长、受国际关系和宏观环境影响重大、行业周期性及不确定性较强、未来盈利情况难以可靠预测的情况。被评估单位成立于 2021 年末，已经建成月产 7 万片 8 英寸硅基产线和月产 5 千片 6 英寸 **SiC MOSFET** 产线，历经生产调试、客户验证、产品导入等阶段，生产和销售规模正在交替扩大，但仍然尚未达到稳定期，目前难以对企业未来的销售情况和所承担的风险进行可靠预测，无法取得动态收入价值比率评估必要的预测营业收入，故不宜采用动态收入价值比率进行评估。

4.运用价值比率

在计算并调整可比企业的价值比率后，与评估对象相应的财务数据或指标相乘，计算得到需要的权益价值或企业价值。最后，对被评估单位的非经营性资产、负债和溢余资产价值进行调整，并考虑流动性对评估对象价值的影响，最终得到被评估单位股权的评估值。

(三) 资产基础法简介

1. 流动资产

评估范围内的流动资产包括货币资金、应收票据、应收账款、应收账款融资、预付账款、其他应收款、存货、其他流动资产。

(1) 货币资金

系银行存款，按核实无误后的账面值作为评估值。

(2) 应收款项

包括应收票据、应收账款、其他应收款。对于各种应收款项，在核实无误的基础上，借助于历史资料和现场调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等，根据每笔款项可能收回的数额确定评估值。对于有充分理由相信全都能收回的，按全部应收款额计算评估值；对于很可能收不回部分款项的，在难以确定收不回账款的数额时，按照账龄分析法，估计出这部分可能收不回的款项，作为风险损失扣除后计算评估值，账面上的“坏账准备”科目评估为零。

(3) 应收款项融资

包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，参考应收票据的评估方法确定评估值。

(4) 预付款项

根据所能收回的相应货物形成资产或权利的价值确定评估值。对于能够收回相应货物或权益的，按核实后的账面值作为评估值。对于有确凿证据表明收不回相应货物，也不能形成相应资产或权益的预付账款，其评估值为零。

(5) 存货

包括原材料、在产品（自制半成品）、产成品（库存商品）。

对于原材料，根据清查核实后的数量乘以现行市场购买价，再加上合理的运杂费、损耗、验收整理入库费及其他合理费用确定评估值。

对于在产品（自制半成品），由于被评估单位采用订单生产模式，故根据对应产成品基准日的不含税销售单价扣减进一步完工成本、销售费用及全部税金后结合账面数量确定评估值。

对于产成品，由于被评估单位采用订单生产模式，故根据其出厂销售价格减去销售费用和全部税金确定评估值。

(6) 其他流动资产

对于购买员工商业保险形成的待摊费用，在了解其产生原因、形成过程并核实金额的准确性的基础上，根据其尚存受益的权利或可收回的资产价值金额确定评估值。

(1) 清查过程中发现，企业作为晶圆代工制造企业，享受可抵扣进项税额加计 15% 抵减应纳税增值税税额的税收政策，本次根据纳税申报表附表载明的企业留抵增值税加计抵减余额确定评估值。

(2) 经现场清查核实，根据绍兴滨海新区管委会（甲方）与绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（乙方）（芯联集成电路制造股份有限公司曾用名）签署的《中芯绍兴二期项目落户协议》，甲方提供如下补贴：①设备补贴：用于项目动力系统、净化系统、供应系统和生产线设备及设备相关的安装费、调试费、测试费、系统软件等投资的 12% 给予现金补贴；②土建补贴：土建工程（含水电、消防等）按合资公司支出的 10% 给予现金补贴，竣工验收合格后补贴，补贴依据以第三方审计的未税发票金额为准，审计报告出具之日起 60 日内兑现到账（以项目备案为限）。

评估人员在查阅相关落户协议、专项审计报告、历史年度取得补贴的会计凭证核实其真实性的基础上对负责政策落实的绍兴集成电路产业园管委会相关负责人员进行了访谈，对协议的真实性、补贴的可得性等进行了论证。

经核实，被评估单位于 2024 年 6 月 30 日收讫 2022 年度设备补贴余款 23,076,999.27 元；截止评估报告出具日，2023 年度设备补贴专项审计工作尚未完成，党工委会议对相关补贴的决策暂未明确，故基于谨慎性原则仅将已收讫的政府补助纳入评估范围，根据实际收讫时点对相关补贴款考虑其时间价值，以其现值作为评估值。

2. 债权投资

对于购买的结构性存款，按本金加持有期应计利息计算评估值。

3. 长期股权投资

对于截止评估基准日尚未开展实际生产经营活动的长期股权投资，按照实际出资额确定评估值。

4. 固定资产

(1) 房屋建筑物类

对于生产性的房屋建筑物和构筑物，采用成本法评估。

成本法评估的基本公式如下：

$$\text{评估值} = \text{重置成本} \times \text{综合成新率}$$

A. 重置成本的确定

重置成本 = 含税建安综合造价 + 前期及其他费用 + 资金成本 - 可抵扣增值税

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号），自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等由缴纳营业税改为缴纳增值税。本次评估在房屋建筑物重置成本中扣除相应的可抵扣增值税税额。

B.综合成新率的确定

综合成新率根据年限法理论成新率和勘察打分法成新率加权平均确定,计算公式如下:

综合成新率=年限法理论成新率×权重+勘察打分法成新率×权重

其中:

年限法理论成新率=(经济使用年限-已使用年限)÷经济使用年限×100%

勘察打分法成新率=(结构评分×权重+装修评分×权重+设备评分×权重)÷100×100%

(2) 设备类

根据各类设备的特点、价值类型、资料收集情况等相关条件,主要采用成本法评估,基本公式如下:

评估值=重置成本×综合成新率

①重置成本的确定

根据《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财税[2008]170号)、《关于固定资产进项税额抵扣问题的通知》(财税[2009]113号)和《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号),对于增值税一般纳税人,购置符合增值税抵扣条件的设备,设备重置成本应扣除相应的可抵扣增值税税额。

A.机器设备

机器设备的重置成本计算公式如下:

重置成本=设备现价+运杂费+安装费+基础费+其它合理费用+资金成本-可抵扣增值税额

B.电子及其他设备

电子及其他设备的重置成本计算公式如下:

重置成本=设备现价-可抵扣增值税额

②综合成新率的确定

A.机器设备

对于价值量较大的机器设备,在年限法理论成新率的基础上,再结合各类因素进行调整,最终确定设备的综合成新率,计算公式如下:

综合成新率=理论成新率×调整系数

其中:

理论成新率=(经济使用年限-已使用年限)÷经济使用年限×100%

调整系数=K1×K2×K3×K4×K5

各项调整因素包括设备的原始制造质量(K1)、维护保养情况(K2)、设备的运行状态及故障频率(K3)、设备的利用率(K4)、设备的环境状况(K5)。

B.电子及其他设备

对于价值量较小的一般电子及其他设备,直接采用年限法确定成新率,计算公式如下:

成新率 = (经济使用年限 - 已使用年限) ÷ 经济使用年限 × 100%

5. 在建工程

在建工程—设备安装工程按基准日汇率重置加计资金成本测算，公式如下：

评估值 = 设备费评估值 + 安装费及其他评估值 + 资金成本评估值

资金成本评估值 = 在建工程含税重置价 × 贷款年利率 × 资金占用周期/2

6. 无形资产

(1) 其他无形资产——软件

对于评估基准日市场上有销售且无升级版本的软件，按照评估基准日的市场价格确定评估值；对于定制软件，以向软件开发商的询价作为评估值。

(2) 其他无形资产——软件使用费及特许使用权

对于软件使用费，在核实受益期和受益额无误的基础上按尚存受益期确定评估值；对于特许使用权，经与管理层访谈，技术授权涉及到产品生产过程中保证良率的生产工艺流程及参数，而该等工艺流程及参数是企业目前生产经营以及支持后续研发迭代、工艺进一步提升的必备基础。同时考虑到技术授权涉及的产品在所处行业内具有先进性，关键工艺技术、产品关键指标处于国际先进水平，故判断特许使用权不存在减值迹象。考虑到相关技术标准衍生、迭代的成果已于技术类无形资产进行评估，故对特许使用权在核实受益期和受益额无误的基础上按尚存受益期确定评估值。

(3) 其他无形资产——技术类无形资产

对于技术类无形资产，评估人员根据形成无形资产的全部投入，考虑无形资产价值与成本的相关程度，通过计算其合理的成本、利润和相关税费后确定其重置成本，并考虑其贬值因素后得到评估对象无形资产市场价值。

7. 长期待摊费用

对于排污权使用费，在核实受益期和受益额无误的基础上按尚存受益期确定评估值；对于不动产改造工程，其所形成的资产或权利已在固定资产-房屋建筑物中反映，对应评估为零；对于办公家具及设备改良支出，采用成本法评估。

8. 其他非流动资产

在了解其他非流动资产的产生原因、形成过程并核实金额的准确性的基础上，根据其尚存受益的权利或可收回的资产价值金额确定评估值。

经现场清查核实，企业账面有预付土地款共计 86,610,269.16 元，根据委托人芯联集成电路制造股份有限公司和被评估单位提供的相关资料，被评估单位作为二期晶圆制造项目的实施主体，在其设立前的土地出让及厂房批建手续均由母公司芯联集成电路制造股份有限公司实施。2022 年 2 月和 4 月，被评估单位分两次合计支付二期土地款共计 86,610,269.16 元，于其他非流动资产科目核算。后一期和二期土地进行合并再分割，并于 2022 年 6 月 20 日按分割后面积办理土地不动产权证。但截止基准日，二期土地使用权证仍在母公司芯联集成电路制造股份有限公司名下，尚未办理权属变更，本次评估考虑到土地不动产权证尚

未进行变更，且双方协议签署时点距离评估基准日时点间工业用地市场未发生重大变化，故对其他非流动资产-预付不动产款按账面值确认评估值。

9. 负债

评估范围内的负债包括短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、递延收益，根据企业实际需要承担的负债项目和金额确定评估值。

八、评估程序实施过程和情况

自接受资产评估业务委托起至出具资产评估报告，主要评估程序实施过程和情况如下：

（一）明确业务基本事项

与委托人进行接洽，明确以下资产评估业务基本事项：（1）委托人、产权持有人和委托人以外的其他资产评估报告使用人；（2）评估目的；（3）评估对象和评估范围；（4）价值类型；（5）评估基准日；（6）资产评估项目所涉及的需要批准的经济行为的审批情况；（7）资产评估报告使用范围；（8）资产评估报告提交期限及方式；（9）评估服务费及支付方式；（10）委托人、其他相关当事人与资产评估机构及其资产评估专业人员工作配合和协助等需要明确的重要事项。

（二）订立业务委托合同

在业务基本事项的基础上，对专业能力、独立性和业务风险进行综合分析和评价。在确保受理该资产评估业务满足专业能力、独立性和业务风险控制要求的情况下，与委托人签订资产评估业务委托合同，约定资产评估机构和委托人权利、义务、违约责任和争议解决等内容。

（三）编制资产评估计划

根据资产评估业务具体情况编制资产评估计划，包括资产评估业务实施的主要过程及时间进度、人员安排等。

（四）进行评估现场调查

采用询问、访谈、核对、监盘、勘查等手段，对评估对象进行现场调查，获取评估业务需要的资料，了解评估对象现状，关注评估对象法律权属。

（五）收集整理评估资料

根据资产评估业务具体情况，收集资产评估业务需要的资料，主要包括：（1）委托人或者其他相关当事人提供的涉及评估对象和评估范围等资料；（2）从政府部门、各类专业机构以及市场等渠道获取的其他资料。采用观察、询问、书面审查、实地调查、查询、函证、复核等方式，对资产评估活动中使用的资料进行核查验证。根据资产评估业务具体情况对收集的评估资料进行分析、归纳和整理，形成评定估算和编制资产评估报告的依据。

（六）评定估算形成结论

根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析市场法、收益法和成本法三种资产评估基本方法及衍生方法的适用性，选择评估方法。在此基础上，根据所采用的评估方法，选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，形成测算结果，并对形成的测算结果进行综合分析，形成评估结论。

（七）编制出具评估报告

资产评估专业人员在评定、估算形成评估结论后，编制初步资产评估报告。资产评估机构按照法律、行政法规、资产评估准则和资产评估机构内部质量控制制度，对初步资产评估报告进行内部审核。项目负责人根据内部审核意见对初步资产评估报告进行修改和完善后，在不影响对评估结论进行独立判断的前提下，与委托人或者委托人同意的其他相关当事人就资产评估报告有关内容进行沟通，根据沟通结果对资产评估报告进行合理完善后，出具并提交正式资产评估报告。

九、评估假设

本资产评估报告分析估算采用的假设条件如下：

（一）一般假设

1.交易假设：即假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

2.公开市场假设：即假定资产可以在充分竞争的市场上自由买卖，其价格高低取决于一定市场的供给状况下独立的买卖双方对资产的价值判断。

3.持续经营假设：即假定一个经营主体的经营活动可以连续下去，在未来可预测的时间内该主体的经营活动不会中止或终止。

（二）特殊假设

1.假设评估基准日后被评估单位所处国家和地区的法律法规、宏观经济形势，以及政治、经济和社会环境无重大变化；

2.假设评估基准日后国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策除公众已获知的变化外，无其他重大变化；

3.假设与被评估单位相关的税收政策、信贷政策不发生重大变化，税率、汇率、利率、政策性征收费用率基本稳定；

4.假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务；

5.假设被评估单位完全遵守所有相关的法律法规，不会出现影响公司发展的重大违规事项；

6.假设委托人及被评估单位提供的基础资料、财务资料 and 经营资料真实、准确、完整；

7.假设评估基准日后无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对被评估单位造成重大不利影响；

8.假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策与编写本资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面基本保持一致；

9.假设评估基准日后被评估单位在现有管理方式和管理水平的基础上,经营范围、方式、业务结构与目前基本保持一致,不考虑未来可能由于管理层、经营策略以及商业环境不可预见性变化的潜在影响。

本评估报告评估结论在上述假设条件下在评估基准日时成立,当上述假设条件发生较大变化时,签字资产评估师及本评估机构将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

十、评估结论

(一) 资产基础法评估结果

经资产基础法评估,被评估单位评估基准日总资产账面价值为 1,054,111.37 万元,评估价值 1,296,777.68 万元,增值额 242,666.31 万元,增值率 23.02%;总负债账面价值 703,897.28 万元,评估价值 695,131.54 万元,减值额 8,765.74 万元,减值率 1.25%;所有者权益(净资产)账面价值 350,214.09 万元,评估价值 601,646.14 万元,增值额 251,432.05 万元,增值率 71.79%。

资产基础法评估结果汇总如下表所示:

资产基础法评估结果汇总表

评估基准日: 2024 年 4 月 30 日

金额单位: 人民币万元

序号	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	151,127.92	166,681.49	15,553.58	10.29
2	非流动资产	902,983.45	1,130,096.18	227,112.73	25.15
3	债权投资	15,845.25	15,845.25	-	0.00
4	其他债权投资	-	-	-	-
5	长期应收款	-	-	-	-
6	长期股权投资	-	-	-	-
7	其他权益工具投资	-	-	-	-
8	其他非流动金融资产	-	-	-	-
9	投资性房地产	-	-	-	-
10	固定资产	746,222.70	864,352.95	118,130.25	15.83
11	在建工程	15,242.81	15,425.77	182.96	1.20
12	生产性生物资产	-	-	-	-
13	油气资产	-	-	-	-
14	使用权资产	-	-	-	-
15	无形资产	72,673.90	181,474.64	108,800.74	149.71

序号	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
16	开发支出	-	-	-	
17	商誉	-	-	-	
18	长期待摊费用	1,351.59	1,350.38	-1.22	-0.09
19	递延所得税资产	-	-	-	
20	其他非流动资产	51,647.20	51,647.20	-	0.00
21	资产总计	1,054,111.37	1,296,777.68	242,666.31	23.02
22	流动负债	203,601.20	203,601.20	-	0.00
23	非流动负债	500,296.07	491,530.33	-8,765.74	-1.75
24	负债合计	703,897.28	695,131.54	-8,765.74	-1.25
25	所有者权益(净资产)	350,214.09	601,646.14	251,432.05	71.79

(二) 市场法评估结果

经市场法评估,被评估单位评估基准日股东全部权益评估值为 815,200.00 万元,比审计后母公司账面所有者权益增值 464,985.91 万元,增值率 132.77%;比审计后合并报表归属于母公司所有者权益增值 464,985.91 万元,增值率 132.77%。

(三) 评估结论

资产基础法评估得出的股东全部权益价值为 601,646.14 万元,市场法评估得出的股东全部权益价值为 815,200.00 万元,两者相差 213,553.86 万元。

资产基础法和市场法评估结果出现差异的主要原因是两种评估方法考虑的角度不同,资产基础法是从资产的再取得途径考虑的,反映的是企业现有资产的重置价值;市场法是从可比公司的市场估值倍数角度考虑的,反映了当前现状企业的市场估值水平。

被评估单位主要从事功率半导体领域的晶圆代工业务,企业的主要价值除固定资产、营运资金等有形资源之外,还应包含企业拥有的技术及加工工艺、研发团队及研发能力、服务能力、市场地位等重要的无形资源的贡献。本次评估虽对技术类无形资产进行了识别辨认,但考虑到企业所处的行业,具有高资本投入、高研发投入及研发周期长、企业投产后产能利用率爬坡期较长等特点,从行业其他可比公司来看,从投产到实现盈利均经历了较长的周期,该期间企业生产时存在规模不经济所带来的亏损,这是行业内同类型企业经营过程中的通常情形,但该成本难以量化,故本次资产基础法中未确认该部分企业发展必须付出的沉没成本。

再从本次经济行为来看,被评估单位作为二期项目的实施方,实际是委托人芯联集成电路制造股份有限公司借助各方资金实现二期项目落地实施。一定程度上来讲,本次并购的实质是并购被评估单位的工艺研发及生产能力,因此,我们认为基于企业价值/总投资的市场法更符合本次并购实质以及该行业特点。

根据上述分析，本评估报告评估结论采用市场法评估结果，即：被评估单位评估基准日的股东全部权益价值评估结论为人民币 815,200.00 万元，大写捌拾壹亿伍仟贰佰万元整。

(四) 本次评估采用市场法的评估结论，增值的原因如下：

正是基于采用市场法评估结论的原因，该公司拥有企业账面值上未反映的技术及加工工艺、研发团队及研发能力、服务能力、市场地位等重要的无形资产价值，因此采用市场法比账面值增值较大。

(五) 关于评估结论的其他考虑因素

本评估报告没有考虑控制权对评估对象价值的影响。本评估报告在市场法评估中考虑了缺乏流动性对评估对象价值的影响。

(六) 评估结论的使用有效期

本评估报告所揭示的评估结论仅对评估报告中描述的经济行为有效，评估结论使用有效期为自评估基准日起一年，即自评估基准日 2024 年 4 月 30 日至 2025 年 4 月 29 日。

十一、特别事项说明

以下为在评估过程中已发现可能影响评估结论但非评估人员执业水平和能力所能评定估算的有关特别事项，评估报告使用人应关注以下特别事项对评估结论和经济行为产生的影响。

(一) 引用其他机构出具报告结论的情况

本次评估无直接引用其他机构出具报告结论的情况。

(二) 权属资料不全面或者存在瑕疵的情形

1、截止评估基准日，纳入本次评估范围的房屋建筑物均已办理竣工验收，但尚未办理不动产权证，房屋建筑物所属土地不动产权证编号为“浙(2022)绍兴市不动产权第 0021554 号”，证载面积为 124,561.15 平方米，土地性质为出让，土地用途为工业用地，土地使用期限为 2068 年 5 月 9 日止，证载权利人为：绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（委托人芯联集成电路制造股份有限公司的曾用名），本次房屋建筑物面积以企业提供的竣工测绘报告的实测面积为依据，最终建筑面积以房管部门颁发的权属证明为准，本次未考虑后续权证办理流程中涉及的相关税费对上述不动产评估价值的影响。

根据委托人芯联集成电路制造股份有限公司和被评估单位提供的相关资料，被评估单位作为委托人二期晶圆制造项目的实施主体，在其设立前的土地出让及厂房批建手续均由母公司芯联集成电路制造股份有限公司实施。2022 年 2 月和 4 月，被评估单位分两次合计支付二期土地款共计 86,610,269.16 元，于其他非流动资产科目核算。后一期和二期土地进行合并再分割，并于 2022 年 6 月 20 日按分割后面积办理土地不动产权证。

2022年9月双方签署《资产转让协议》，约定二期土地转让款为90,310,000.00元，与前述已支付款项差异尚未结算。本次评估考虑到土地不动产权证尚未进行变更，且双方协议签署时点距离评估基准日时点间工业用地市场未发生重大变化，故对其他非流动资产-预付不动产款按账面值确认评估值。

2、截至评估基准日，企业存在以下抵押事项：

序号	抵押物	抵押权人	抵押期限
1	根据抵押合同（合同编号：2022年绍银团抵字第002号），芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司将其拥有的177（个/台/套）集成电路设备进行抵押，协议作价人民币3,004,800,569.82元。	招商银行股份有限公司绍兴分行 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行 北京银行股份有限公司绍兴分行 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 中国工商银行股份有限公司绍兴越城支行	2024/4/2-2034/1/1

经现场清查核实，上述抵押物于被评估单位账务系统中登记为179（个/台/套），截止评估基准日相关抵押资产账面原值2,832,920,350.19元，账面净值2,087,148,346.31元。

3、根据芯联集成电路制造股份有限公司、芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司与中芯国际集成电路制造有限公司沟通，报告期内芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司及其子公司新增拥有的专利涉及与中芯国际集成电路制造有限公司专利共有确权的情况，相关专利的证载权利人变更程序将待确权工作完成后进行（如需）。

本次评估未考虑上述房地产权属瑕疵、设备抵押等事项对评估结论的可能影响，提醒报告使用者注意。

（三）评估程序受到限制的情形

本次评估无评估程序受到限制的情形。

（四）评估资料不完整的情形

本次评估未发现重要评估资料存在不完整的情形。

（五）评估基准日存在的法律、经济等未决事项

本次评估未发现评估基准日存在法律、经济等未决事项。

（六）担保、租赁及其或有负债（或有资产）事项

企业存在房产租赁事项，概况如下：

序号	租赁地址	出租方	承租方	租赁期限	租赁面积（m ² ） （基准日当月）
1	浙江绍兴市越城区临江路518号	芯联集成电路制造股份有限公司	芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司	租赁面积每月浮动，双方据实结算	15,953.00
2	浙江绍兴市越城区临江路518号	芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司	芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司	租赁面积每月浮动，双方据实结算	74,379.10

（七）评估基准日至资产评估报告日之间可能对评估结论产生影响的事项

本次评估在评估基准日至资产评估报告日之间未发现可能对评估结论产生影响的重大期后事项。

(八) 本次经济行为中可能对评估结论产生重大影响的瑕疵情形

在本次资产评估对应的经济行为中,未发现可能对评估结论产生重大影响的瑕疵情形。

(九) 其他需要说明的事项

1、本次评估历史年度及评估基准日的账面值利用大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司审计报告》,报告编号为“大信审字[2024]第 32-00068 号”,报告出具日为 2024 年 8 月 19 日,审计意见为无保留意见。资产评估专业人员根据所采用的评估方法对财务报表的使用要求对其进行了分析和判断,但对相关财务报表是否公允反映评估基准日企业的财务状况和当期经营成果、现金流量发表专业意见并非资产评估专业人员的责任。

根据现行评估准则的相关规定,我们对利用相关专业报告仅承担引用不当的相关责任。

2、经现场清查核实,根据绍兴滨海新区管委会(甲方)与绍兴中芯集成电路制造股份有限公司(乙方)(芯联集成电路制造股份有限公司曾用名)签署的《中芯绍兴二期项目落户协议》,甲方提供如下补贴:①设备补贴:用于项目动力系统、净化系统、供应系统和生产线设备及设备相关的安装费、调试费、测试费、系统软件等投资的 12%给予现金补贴;②土建补贴:土建工程(含水电、消防等)按合资公司支出的 10%给予现金补贴,竣工验收合格后补贴,补贴依据以第三方审计的未税发票金额为准,审计报告出具之日起 60 日内兑现到账(以项目备案为限)。

评估人员在查阅相关落户协议、专项审计报告、历史年度取得补贴的会计凭证核实其真实性的基础上对负责政策落实的绍兴集成电路产业园管委会相关负责人员进行了访谈,对协议的真实性、补贴的可得性等进行了论证。

经核实,被评估单位于 2024 年 6 月 30 日收讫 2022 年度设备补贴余款 23,076,999.27 元;截止评估报告出具日,2023 年度设备补贴专项审计工作尚未完成,党工委会议对相关补贴的决策暂未明确,故基于谨慎性原则仅将已收讫的政府补助纳入评估范围,根据实际收讫时点对相关补贴款考虑其时间价值,以其现值作为评估值。

3、本资产评估报告中,所有以万元为金额单位的表格或者文字表述,若存在合计数与各分项数值之和出现尾差的情况,均系四舍五入原因造成。

4、评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见,并不承担相关当事人决策的责任。评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

5、委托人及被评估单位所提供的资料是进行本次资产评估的基础,委托人和被评估单位应对所提供资料的真实性、合法性和完整性承担责任。

6、在评估基准日以后的有效期内,如果资产数量及作价标准发生变化,对评估结论造成影响时,不能直接使用本评估结论,须对评估结论进行调整或重新评估。

十二、资产评估报告使用限制说明

本资产评估报告的使用范围如下：仅供委托人和资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人使用；仅限用于本资产评估报告载明的评估目的；仅限在本资产评估报告载明的评估结论使用有效期内使用；未征得本资产评估机构同意，资产评估报告的内容不得被摘抄、引用或者披露于公开媒体，法律、行政法规规定以及相关当事人另有约定的除外。

委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。

除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

本资产评估报告经资产评估师签字、评估机构盖章后方可正式使用。

十三、资产评估报告日

资产评估报告日为 2024 年 8 月 19 日。（此页以下无正文）

(本页无正文,系金证评报字【2024】第 0269 号资产评估报告签章页)

资产评估机构:金证(上海)资产评估有限公司



资产评估师: 杨洁



资产评估师: [Signature]



资产评估报告日: 2024 年 8 月 19 日

地址: 上海市黄浦区龙华东路 868 号外滩中心办公 A 座 1303 室

邮编: 200023 电话: 021-63081130 传真: 021-63081131 电子邮箱: contact@jzvaluation.com